

2022年3月期  
(2021年4月1日 ~ 2022年3月31日)

# 決算説明資料

**ENOMOTO Co.,Ltd.**

東証プライム 証券コード:6928

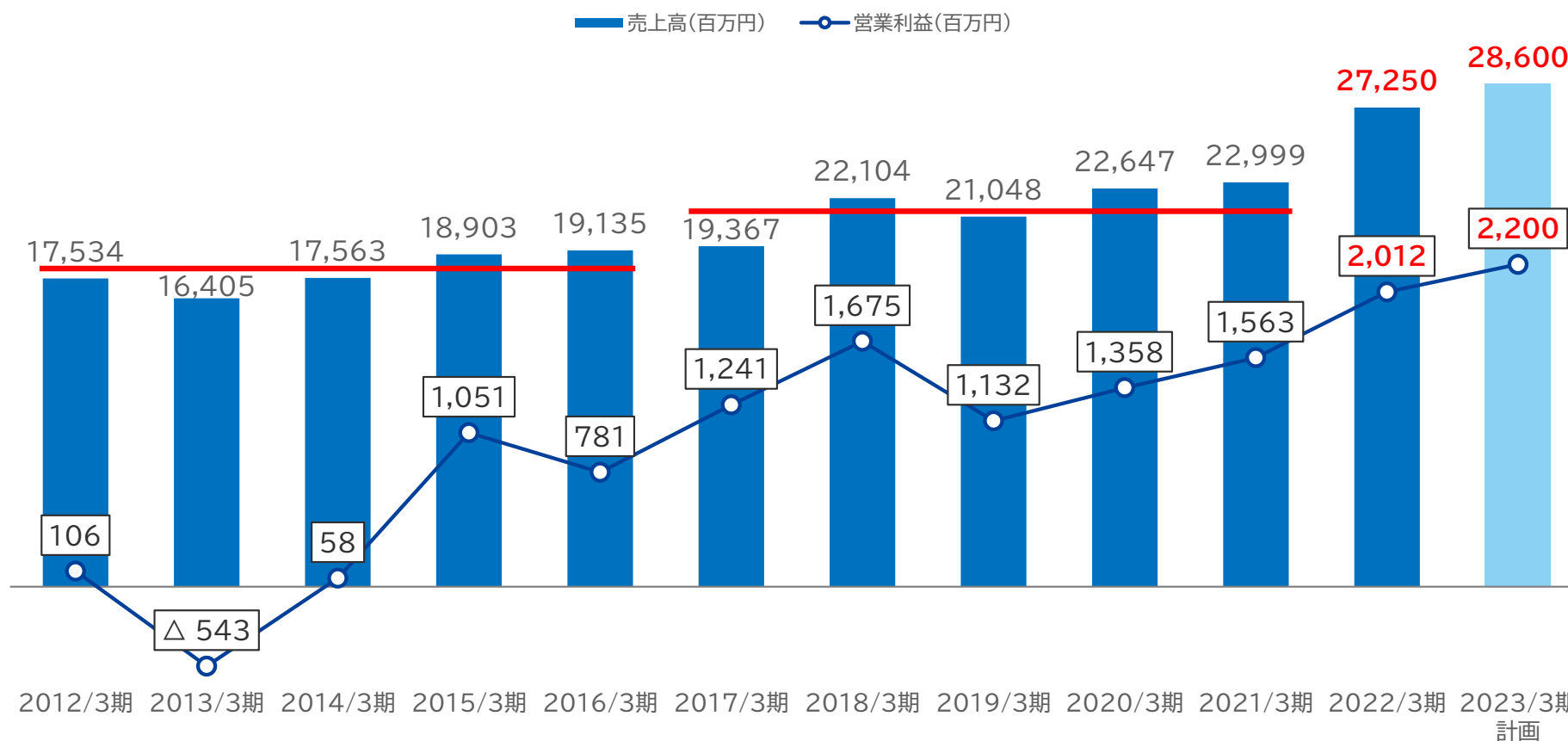
|                       |      |
|-----------------------|------|
| 1. 業績概要               | P. 3 |
| 2. 市場環境と当社製品          | P. 6 |
| 3. 特長・強み              | P.14 |
| 4. 2022年3月期決算         | P.18 |
| 5. 2023年3月期業績予想       | P.23 |
| 6. 中期経営計画の進捗          | P.26 |
| 7. 中期環境計画(SDGsへの取り組み) | P.34 |
| Appendix              | P.38 |

# 1.業績概要



- 2021年3月期までの5年間は、スマートフォン向けの狭ピッチコネクタ等の成長により売上高200億円前後・営業利益も15億円前後に
- 2022年3月期は売上高272億円、営業利益20億円(過去最高)に達し新たなステージへ

## 売上高・営業利益の推移



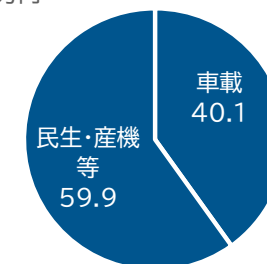
- ・ リードフレームでは車載や5G基地局向けなどにパワー半導体向け製品が伸長
- ・ コネクタ部品ではスマートフォンやウェアラブル端末向けの狭ピッチ、低背製品が伸長
- ・ リードフレーム、コネクタ部品それぞれ約50%とバランスが取れた事業構成

## その他

売上高 679百万円  
 構成比 2.5%

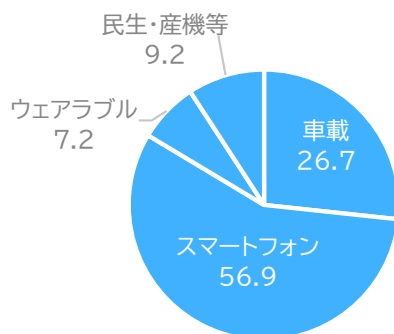
## IC・トランジスタ用リードフレーム

売上高 9,929百万円  
 構成比 36.5%



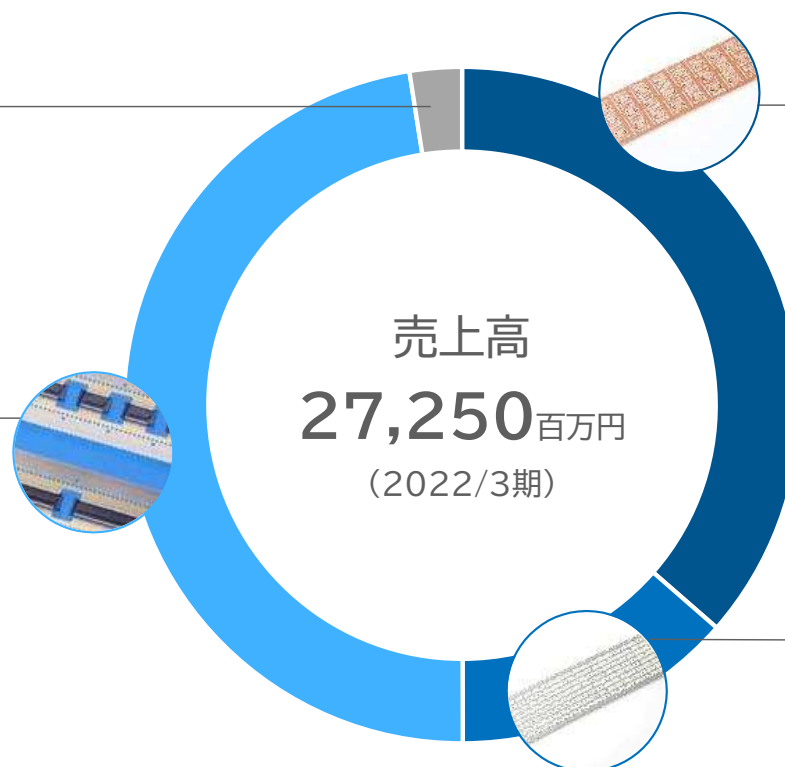
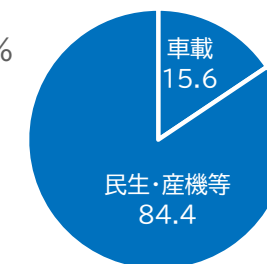
## コネクタ部品

売上高 12,955百万円  
 構成比 47.5%



## オプト用リードフレーム

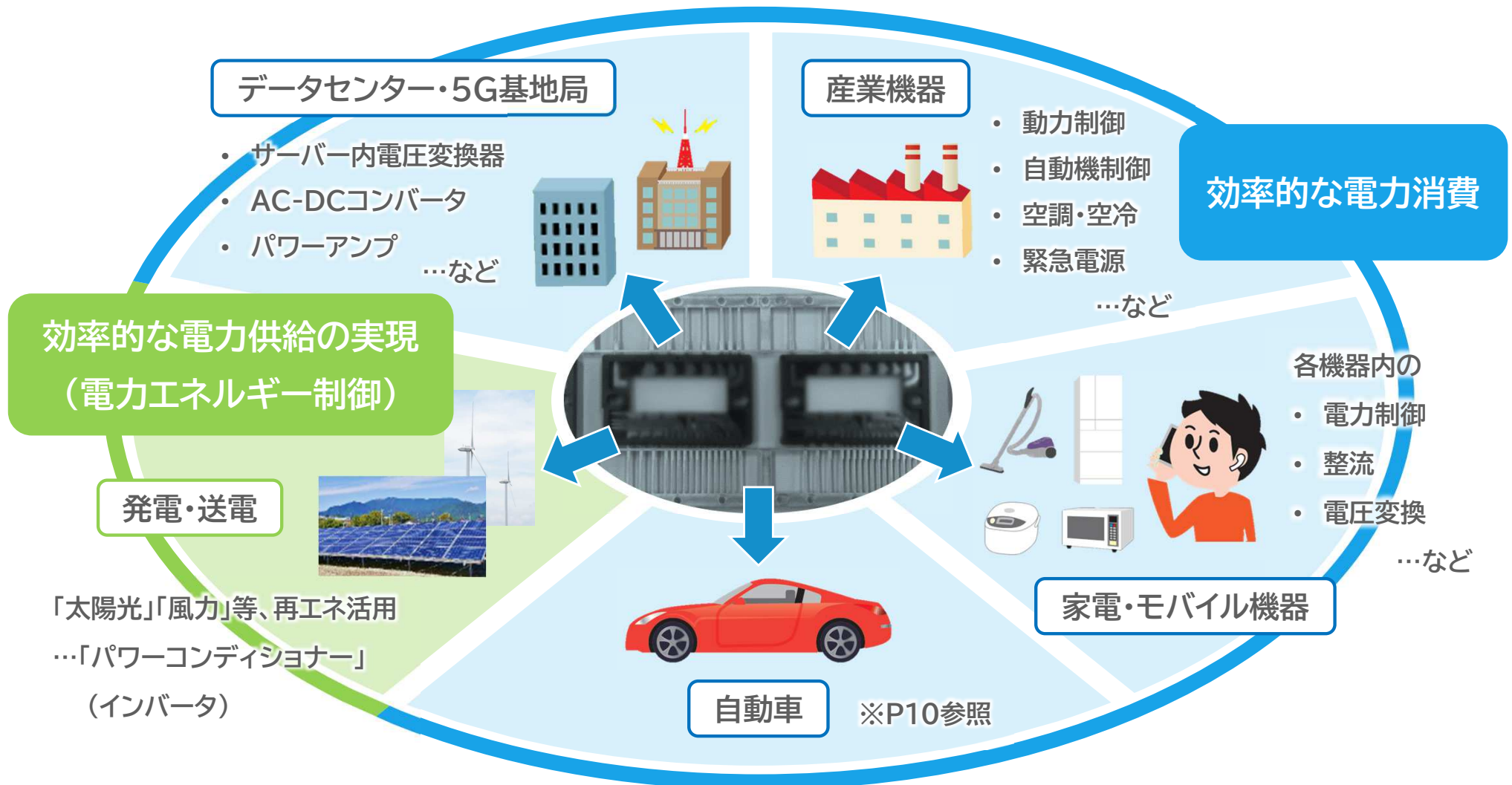
売上高 3,686百万円  
 構成比 13.5%



## 2.市場環境と当社製品



- 環境側面からも、新たな発電技術の開発・発展、高効率な電力供給を支える高機能パワー半導体に注目が集まる
- SiC・GaNパワー半導体を使うことで、高電圧・高電流化に加え低損失を実現し、高出力・省エネに寄与

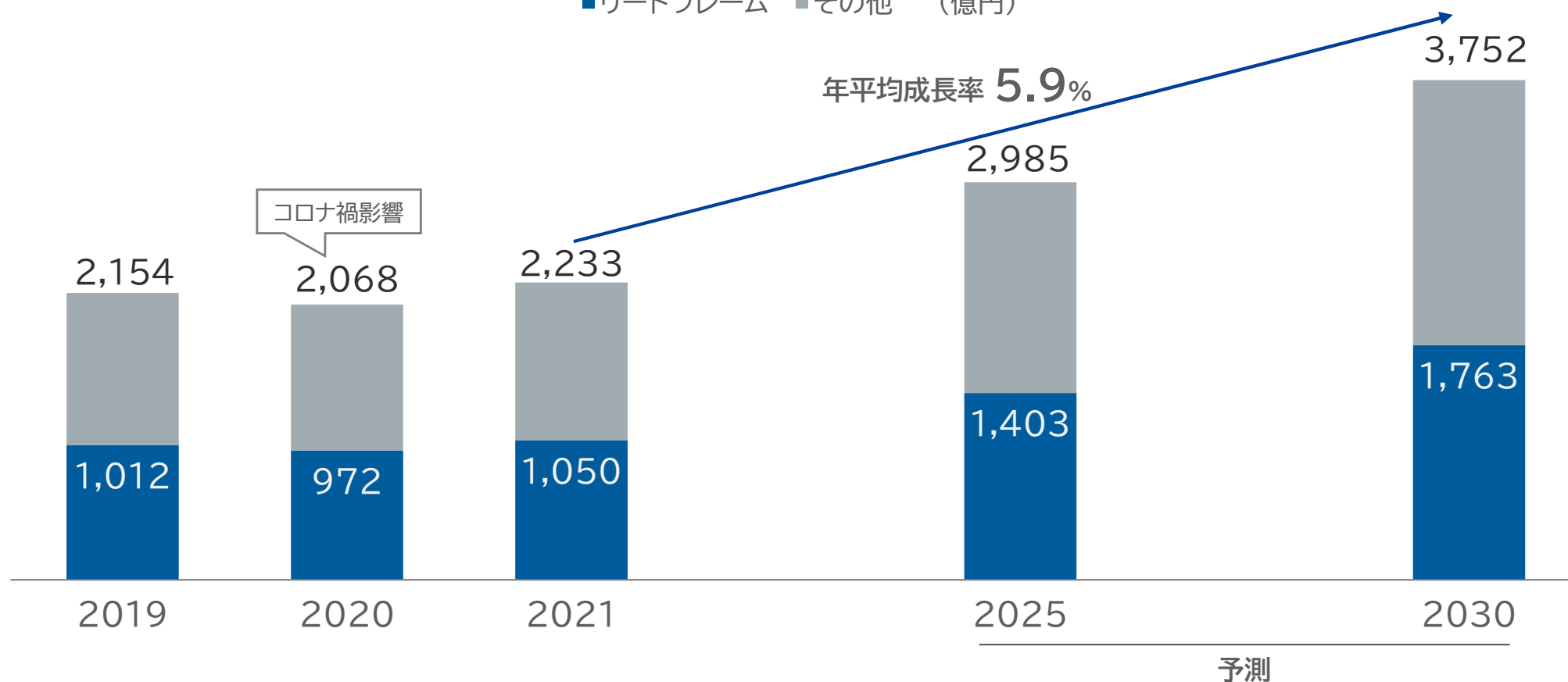


\* SiCはSilicon Carbide(炭化ケイ素)、GaNはGallium Nitride(窒化ガリウム)の略

- ・ リードフレームを含むパワー半導体構成部材\*は年平均5.9%成長、2030年には3,752億円へ
- ・ 構成部材のうち、約47%がリードフレームと推定

パワー半導体構成部材の市場予測

■ リードフレーム ■ その他 (億円)



\* 構成部材の市場はパワー半導体市場の内訳  
出所:富士経済「2021年版 次世代パワーデバイス&パワーエレ関連機器市場の現状と将来展望」



- 車載ECU\*1や産業機器向けパワー半導体の高電圧・高電流化に伴い、従来のリードフレームを上回る高信頼性と省スペース化の要求から接触面積が大きく、通電容量の高いクリップボンディング\*2の注目が高まる
- 需要は拡大しており今期に前倒しで生産能力を増強。平坦度などの品質要求が高く付加価値率も高い

車載・産業用パワー半導体

小型化

高電流化

モジュール化



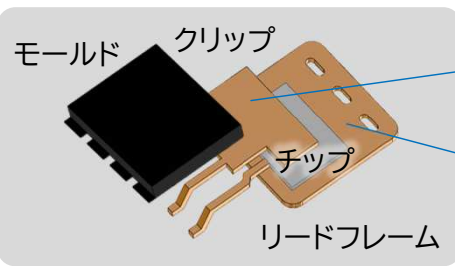
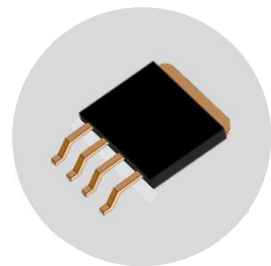
従来品を上回る高信頼性と省スペース性

## クリップボンディングリードフレーム

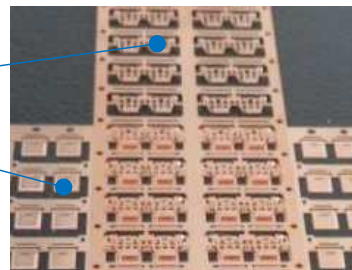
高耐熱性

長寿命化

完成品



当社製品



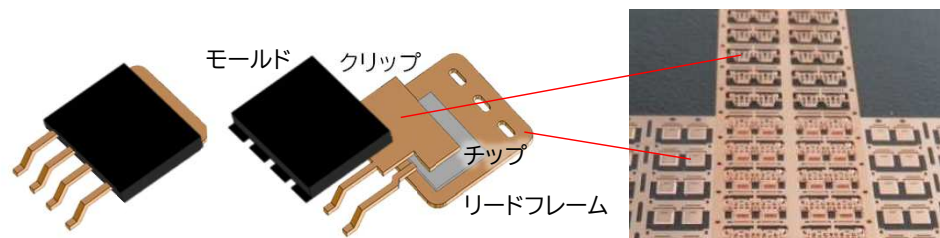
- クリップとリードフレームでチップを挟み込むため大きな面で接続でき、電気特性と熱特性が高まる
- 平坦度が低いと非接触部分ができパワー半導体の電流量が低下

平坦度・清浄度・位置精度の要求が高く、高い付加価値率  
他社に先駆けて本格量産開始

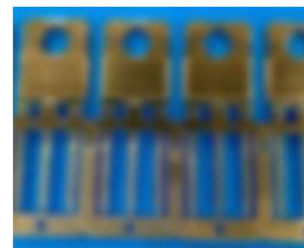
\*1 ECU Electronic Control Unit

\*2 クリップボンディング ワイヤレスボンディングから表記を変更

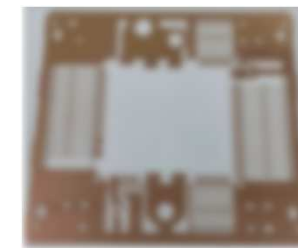
## クリップボンディング方式パワー半導体用リードフレーム



パワー半導体用  
リードフレーム



IGBT用  
リードフレーム



ICレギュレータ用  
リードフレーム



※上記部品が後工程を経てパワーデバイスモジュールを構成し、車載(制御系など)に使用される

## パワーデバイス適用製品 計40品種以上

### ボディ制御

- パワーウィンドウ
- オートマチックドアロック
- 電動シート
- ライト制御
- ナビコン
- マイコンエアコン



### 車両制御

- ステアリング制御
- クルーズ制御

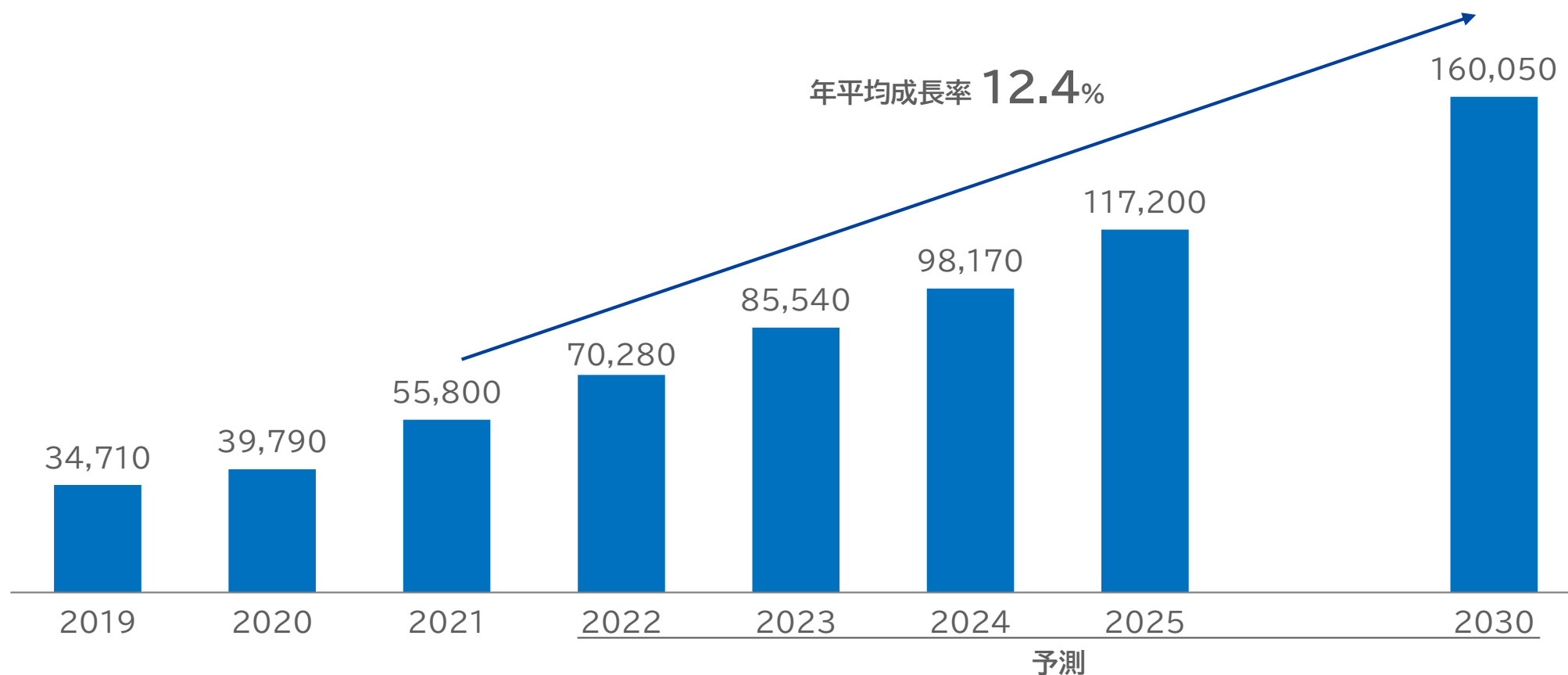
### パワートレイン制御

- ICレギュレータ
- オルタネータ
- エンジン制御
- トランスミッション制御
- ラジエーターファン制御

- 車載向けパワーデバイスモジュールは、日本ではHV向け製品、欧州、北米、中国はPHV\*やEV向けの製品が拡大していく見通し
- 2030年までに出荷数量は年平均12.4%成長を予測

車載向けパワーデバイスモジュールの出荷数量

■ 出荷数量(千個)



\* PHVはPlug in Hybrid Vehicle の略  
出所:富士キメラ総研「2021 次世代カーテクノロジーの本命予測」

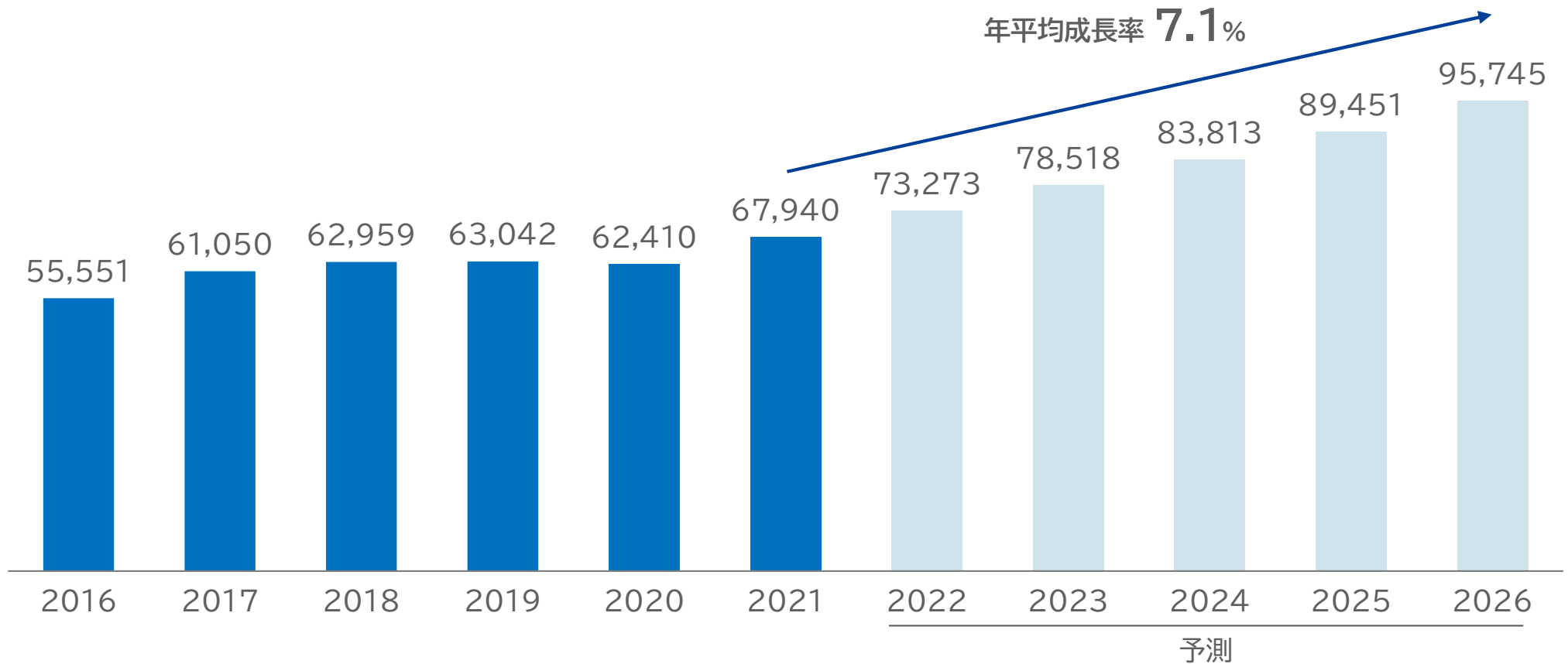
- スマートフォン・ウェアラブル端末向けの極小部品から、自動車向けの特殊で大きな部品まで幅広く対応
- 超微細な部品を高品質大量生産



- コネクタ市場も年平均7.1%の成長が続くと予想
- 2020年以降は車載向け部品の搭載率上昇、スマートフォンの高機能化やウェアラブル端末などのワイヤレス化が市場を牽引

## コネクタ世界市場規模の推移と需要予測

単位:億円



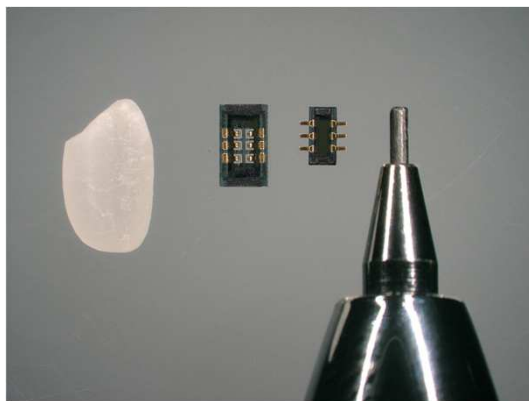
出所:産業情報調査会「2021年版 コネクタ市場」

# 3. 特長・強み



1

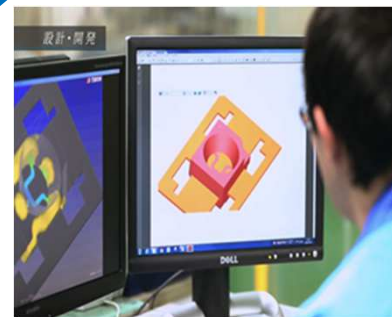
金属と樹脂の複合加工技術力



技術力

2

高品質・大量生産体制を支える  
生産技術力



3

海外でも日本品質の生産体制



フィリピン



中国

一貫生産

4

独立系としてのサービスポジション

材料メーカーや  
協力会社

幅広い顧客  
ニーズ

最適な調達

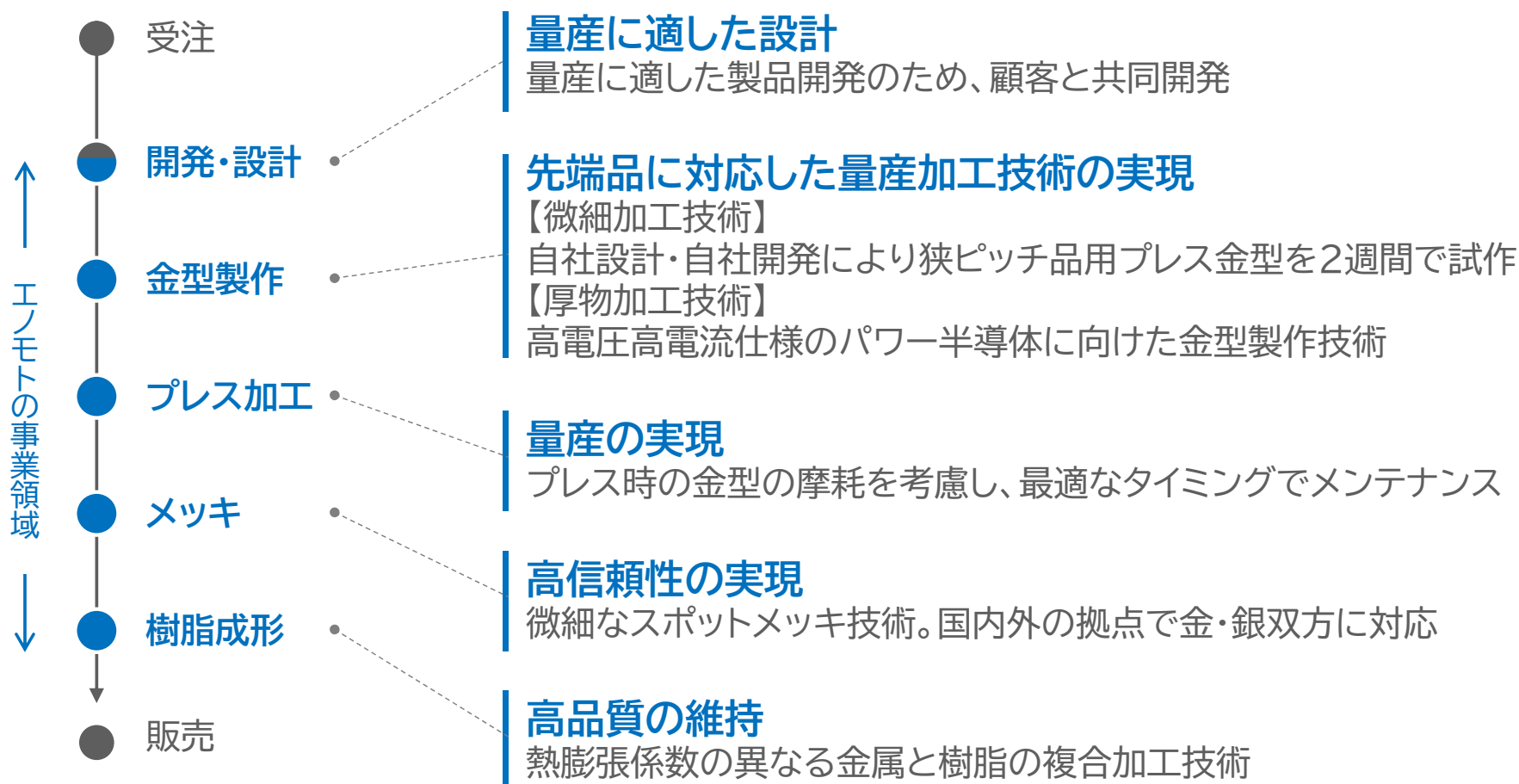
エノモト

柔軟な対応

特定の資本に縛られない  
自由な営業方針



- ・ 強みである金型の設計・開発、プレス加工の技術を活かし、生産に特化
- ・ スマートフォン向けなどの狭ピッチコネクタ、パワー半導体用リードフレームの精密加工に強み
- ・ 狭ピッチコネクタ、クリップボンディングリードフレームを大量生産できる企業は限られ、当社への受注が増加

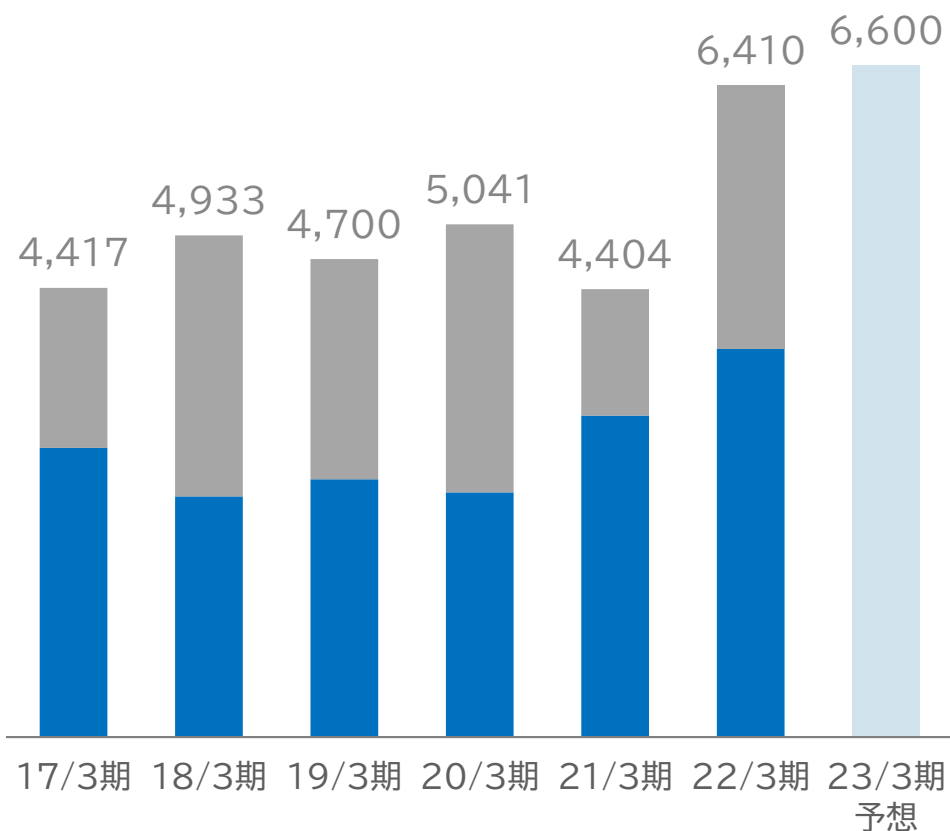




- 日系機器メーカーの工場移転や海外企業の台頭に対応し、中国・フィリピンでも金型から一貫生産
- 中国工場ではクリップボンディングリードフレームを国内メーカーに先駆けて大量生産  
→日本企業と同タイプ製品への本格参入にあたり、当社グループによる受注の優位性に
- フィリピン工場では車載向け部品が成長

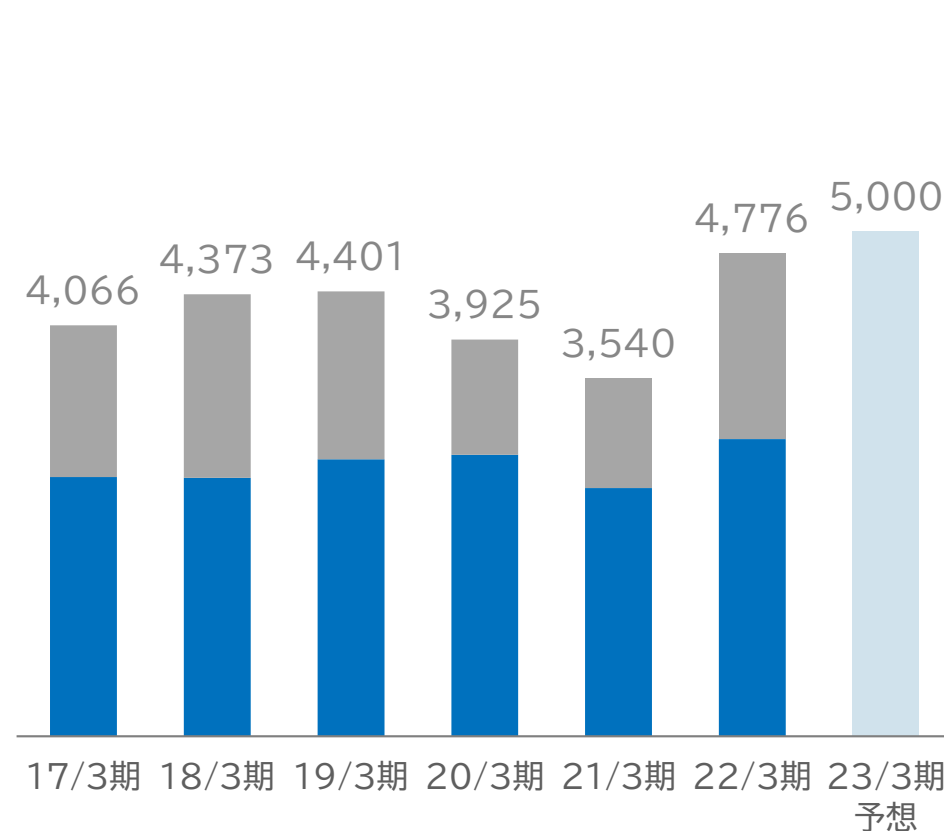
### 中国子会社の売上高推移

■内、パワー半導体用リードフレーム(百万円)



### フィリピン子会社の売上高推移

■内、車載向け部品(百万円)



# 4.2022年3月期決算



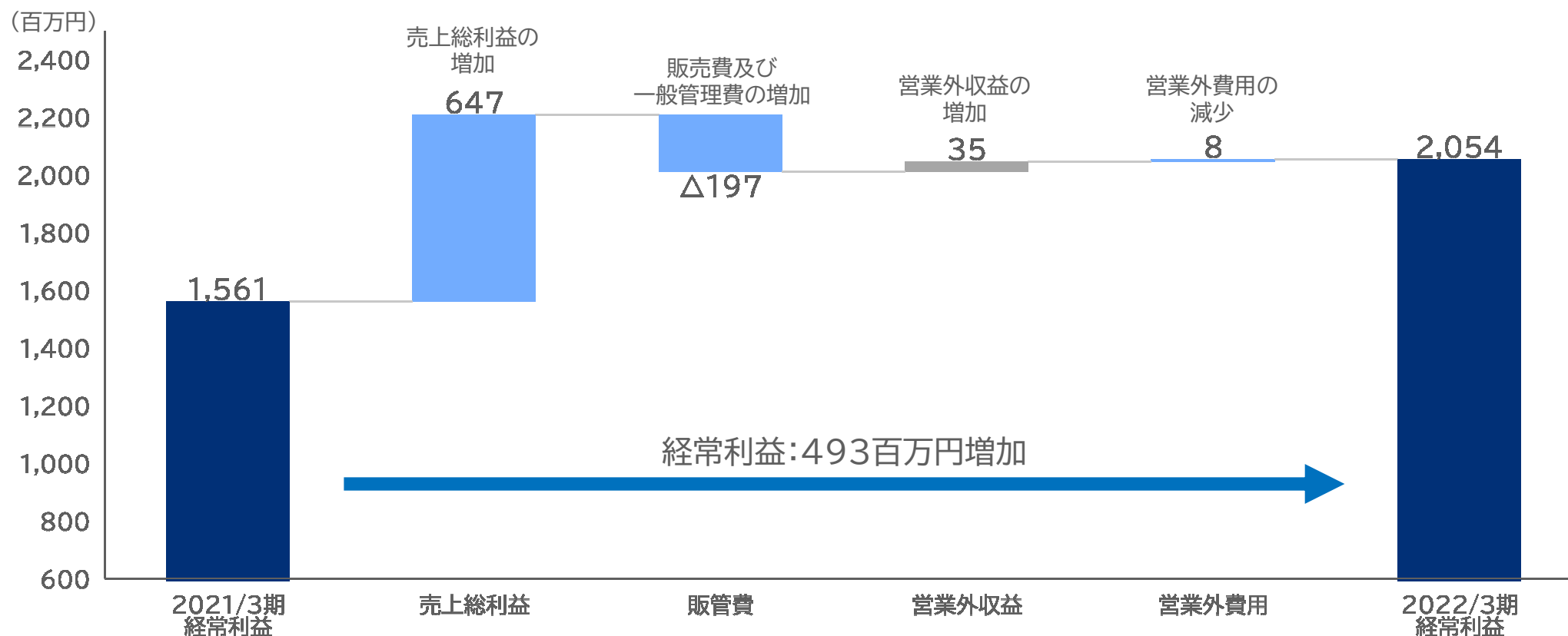
- ・ 2021年3月期下期からの産業用機器の需要回復に加え、自動車の電装化加速及びDX・GXなど社会革新を支えるパワー半導体への強い需要が追い風に
- ・ スマートフォンやウェアラブル端末などへの消費マインドは改善基調が継続
- ・ 銅などの素材高は概ね売価に転嫁、増収効果などにより営業利益は前期比29%増の20億円に

|          | 2021/3期 |        | 2022/3期 |        | 期比較    |           |
|----------|---------|--------|---------|--------|--------|-----------|
|          | 実績(百万円) | 売上比(%) | 実績(百万円) | 売上比(%) | 前年比(%) | 売上比増減(pt) |
| 売上高      | 22,999  | 100.0  | 27,250  | 100.0  | +18.5  | -         |
| 売上総利益    | 3,815   | 16.6   | 4,462   | 16.4   | +16.9  | △0.2      |
| 販管費      | 2,252   | 9.8    | 2,449   | 9.0    | +8.8   | △0.8      |
| 営業利益     | 1,563   | 6.8    | 2,012   | 7.4    | +28.7  | +0.6      |
| 為替差損益    | △43     | -      | 34      | -      | -      | -         |
| 経常利益     | 1,561   | 6.8    | 2,054   | 7.5    | +31.5  | +0.7      |
| 当期純利益    | 1,489   | 6.5    | 1,545   | 5.7    | +3.8   | △0.8      |
| 1株当たり純利益 | 221.6円  | -      | 230.5円  | -      |        |           |

- ・ IC・トランジスタ用リードフレームは、自動車向けや産業用機械向けを中心にパワー半導体向けが好調を継続
- ・ オプト用リードフレームは、交通インフラをはじめディスプレイや自動車向けのLEDを中心に需要増加
- ・ コネクタ用部品は、スマートフォン向けが下期は季節調整、一方でウェアラブル端末向けが復調、車載向けは堅調

| 単位:百万円                | 2021/3期 |       |       |       |        | 2022/3期 |       |       |       |        |        |
|-----------------------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|
|                       | 1Q      | 2Q    | 3Q    | 4Q    | 通期     | 1Q      | 2Q    | 3Q    | 4Q    | 通期     | 前年比    |
| IC・トランジスタ用<br>リードフレーム | 1,735   | 1,516 | 1,911 | 2,123 | 7,287  | 2,380   | 2,288 | 2,614 | 2,646 | 9,929  | +36.3% |
| オプト用<br>リードフレーム       | 678     | 615   | 530   | 814   | 2,639  | 969     | 921   | 878   | 918   | 3,686  | +39.7% |
| コネクタ用部品               | 2,530   | 3,054 | 3,686 | 3,112 | 12,384 | 3,320   | 3,440 | 3,353 | 2,840 | 12,955 | +4.6%  |
| その他                   | 168     | 164   | 168   | 187   | 688    | 195     | 198   | 145   | 141   | 679    | △1.4%  |
| 合計                    | 5,113   | 5,351 | 6,296 | 6,238 | 22,999 | 6,866   | 6,848 | 6,992 | 6,545 | 27,250 | +18.5% |

- 売上総利益の増加 … リードフレーム、コネクタ用部品共に好調な推移
- 販売費及び一般管理費の増加 … ①取引量の増大と物流単価の高騰による運賃搬送費の増加  
②業務効率化を図る新ERP導入に伴う機器購入費用が一時的に増加
- 営業外利益の増加 … 為替差益の増加等



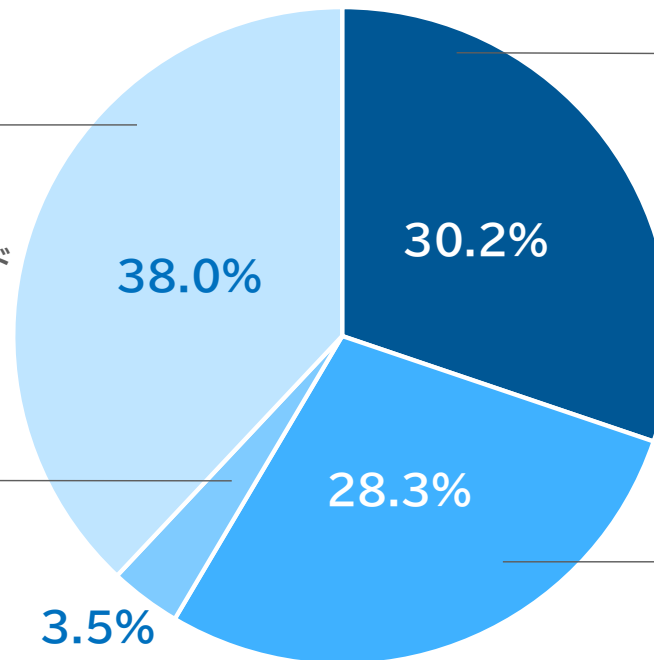
- 各用途とも堅調に推移、特にパワー半導体用リードフレームや交通インフラ等のディスプレイ向けLED用リードフレームなどが大きく伸長
- スマートフォン向けは前期比増収となったが、下期の季節調整により構成比は低下
- ウェアラブル向けは、上期に新商品発売前の一時的な生産調整があったが、市場は成長中であり下期より復調

## 民生・産機・その他

- 構成比は前年同期の31.0%から 7.0pt増加
- 汎用的用途のパワー半導体用リードフレームや交通インフラ等のディスプレイ向けLED用リードフレームなどが増加

## ウェアラブル

- 構成比は前年同期の5.3%から 1.8pt減少
- 季節的要因および昨年後半以降の急伸から上期に一時的な調整があったが10月から回復



## 車載

- 構成比は前年同期の29.0%から 1.2pt増加
- 自動車の需要回復により、パワー半導体用リードフレーム、エアバッグ用コネクタ、各種照明向けLED用リードフレーム等が復調

## スマートフォン

- 構成比は前年同期の34.7%から 6.4pt減少
- 当期モデルは立ち上がりが早く1Qから出荷開始
- 季節要因により12月頃からピークアウト

# 5.2023年3月期業績予想



- ・ パワー半導体向けを中心とするリードフレームが牽引し、売上高は過去最高の286億円を予想
- ・ 津軽工場増設やパワー半導体用リードフレーム増産等による減価償却費の増加1.5億円を吸収し  
営業利益は9%増の22億円、当期純利益も6%増の16.5億円といずれも過去最高を予想

|          | 2022/3期 |        | 2023/3期 |        | 期比較    |           |
|----------|---------|--------|---------|--------|--------|-----------|
|          | 実績(百万円) | 売上比(%) | 予想(百万円) | 売上比(%) | 前年比(%) | 売上比増減(pt) |
| 売上高      | 27,250  | 100.0  | 28,600  | 100.0  | +5.0   | -         |
| 売上総利益    | 4,462   | 16.4   | 4,650   | 16.3   | +4.2   | △0.1      |
| 販管費      | 2,449   | 9.0    | 2,450   | 8.6    | +0.0   | △0.4      |
| 営業利益     | 2,012   | 7.4    | 2,200   | 7.7    | +9.3   | +0.3      |
| 経常利益     | 2,054   | 7.5    | 2,200   | 7.7    | +7.1   | +0.2      |
| 当期純利益    | 1,545   | 5.7    | 1,650   | 5.8    | +6.8   | +0.1      |
| 1株当たり純利益 | 230.5円  | -      | 247.4円  | -      | -      | -         |



- IC・トランジスタ用リードフレームはパワー半導体向け等が増加、クリップボンディングリードフレームの生産能力増強も貢献
- オプト用リードフレームは横ばいで推移
- コネクタ用部品は、スマートフォンの普及一巡による影響はあるがウェアラブル端末向けが成長

|                       | 2022/3期 |        | 2023/3期 |        |        |
|-----------------------|---------|--------|---------|--------|--------|
|                       | 実績(百万円) | 構成比(%) | 予想(百万円) | 構成比(%) | 前年比(%) |
| IC・トランジスタ用<br>リードフレーム | 9,929   | 36.4   | 11,000  | 38.5   | +10.8  |
| オプト用<br>リードフレーム       | 3,686   | 13.5   | 3,600   | 12.6   | △2.3   |
| コネクタ用部品               | 12,955  | 47.5   | 13,700  | 47.9   | +5.8   |
| その他                   | 679     | 2.5    | 300     | 1.1    | △55.8  |
| 合計                    | 27,250  | 100.0  | 28,600  | 100.0  | +5.0   |

## 6. 中期経営計画の進捗





社是

心技一体

経営理念

経営の中心は人であり、健全なものづくりを通じて、豊かな社会の実現に貢献する。

## ビジョン2030

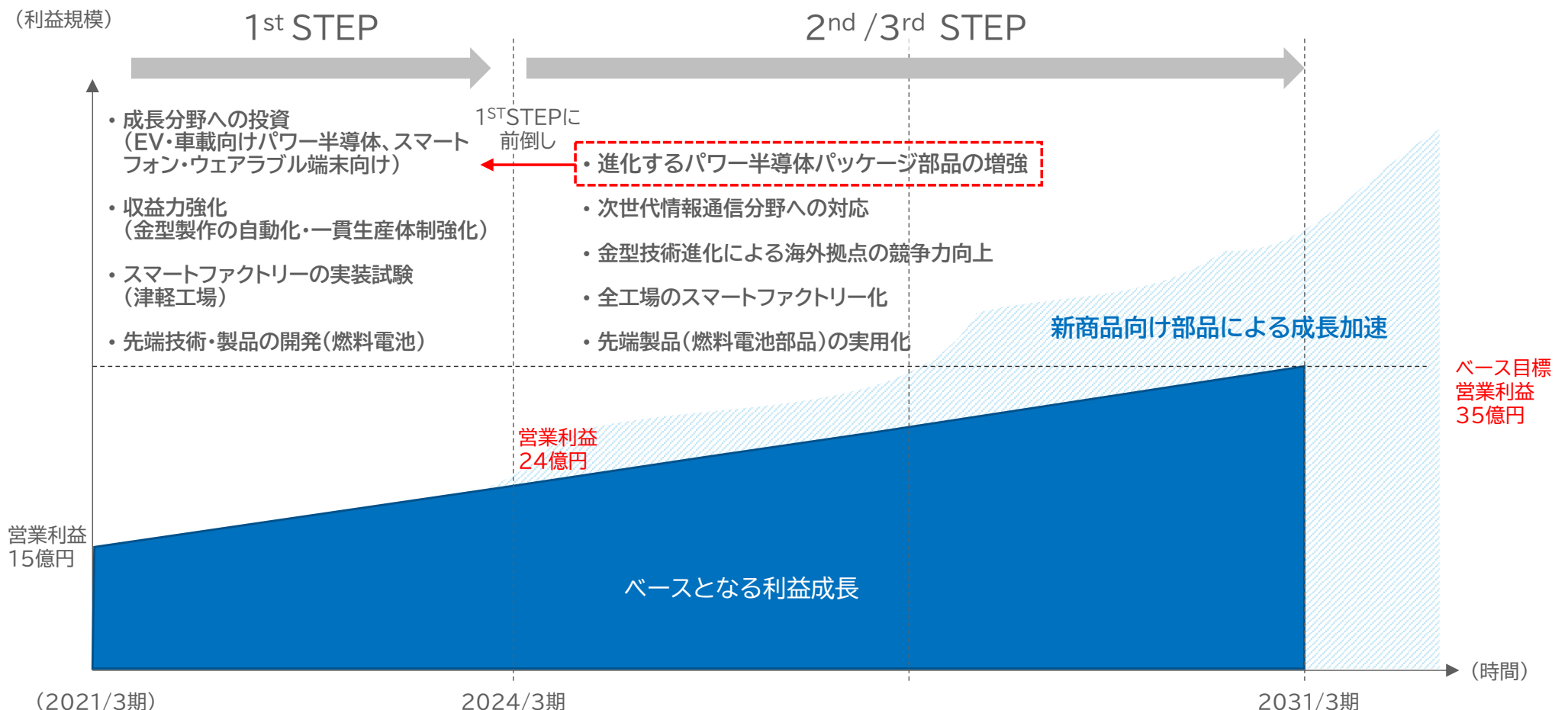
「金型の技術で未来を創る」

より小さく より速く 最先端の技術で  
暮らしとビジネスのベストパートナーを目指す

## ありたい姿

- 金型技術の進化で、最先端の市場に高品質な部品をスピーディに提供し続ける
- 失敗を恐れずチャレンジする職場環境づくりを通じてイノベーションを生み出す
- 燃料電池部品の実用化で脱炭素社会の実現に貢献する

- ・ ビジョン2030では、既存製品の需要拡大を見据えつつ、付加価値率の向上を軸とした各種施策で主力製品のマーケットの成長を上回る利益成長を図る
- ・ 2nd STEPで計画していたパワー半導体パッケージ部品の増強を1st STEPに前倒して実施予定
- ・ 津軽工場の増築工事は予定通り完了し、1月より稼働開始



- 津軽工場増築は計画通り11月末竣工し、1月より本格稼働開始
- スマートフォンやウェアラブルデバイス等に向けた最先端製品と、メッキ加工の生産能力増強



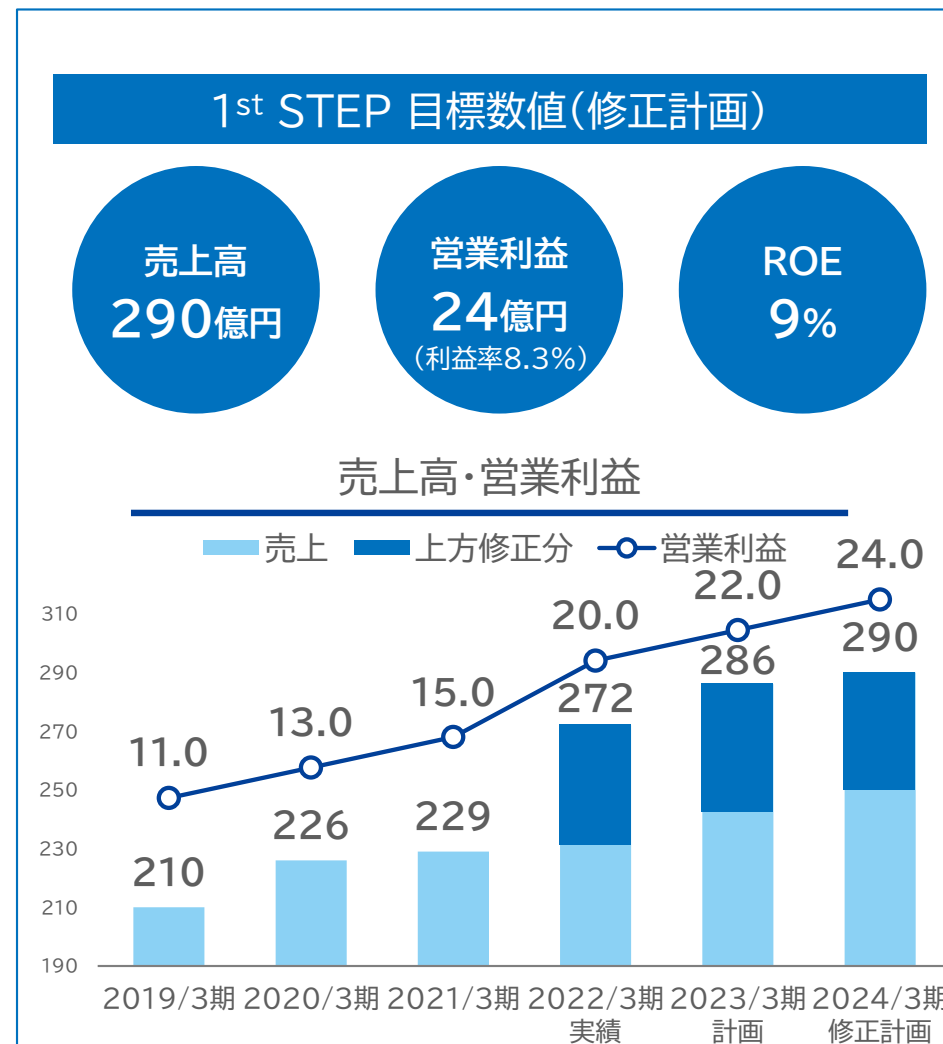
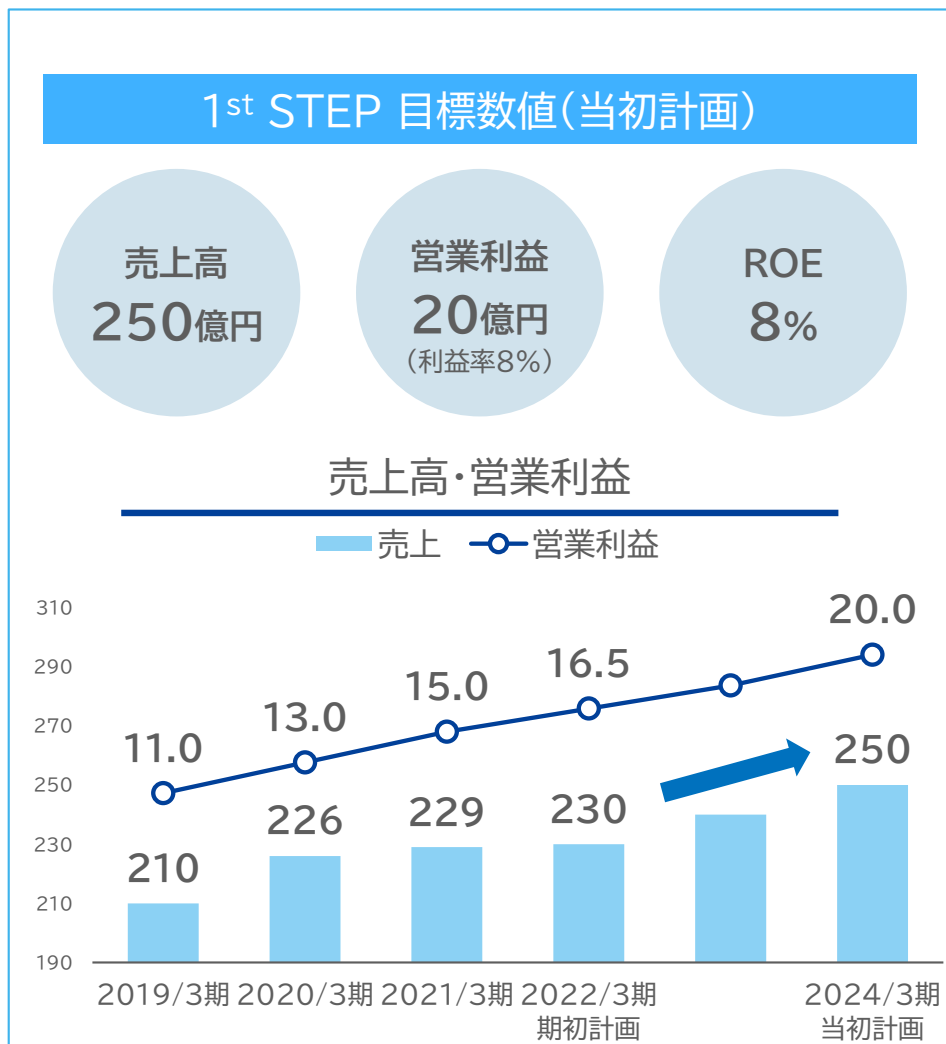
プレスライン



成形ライン

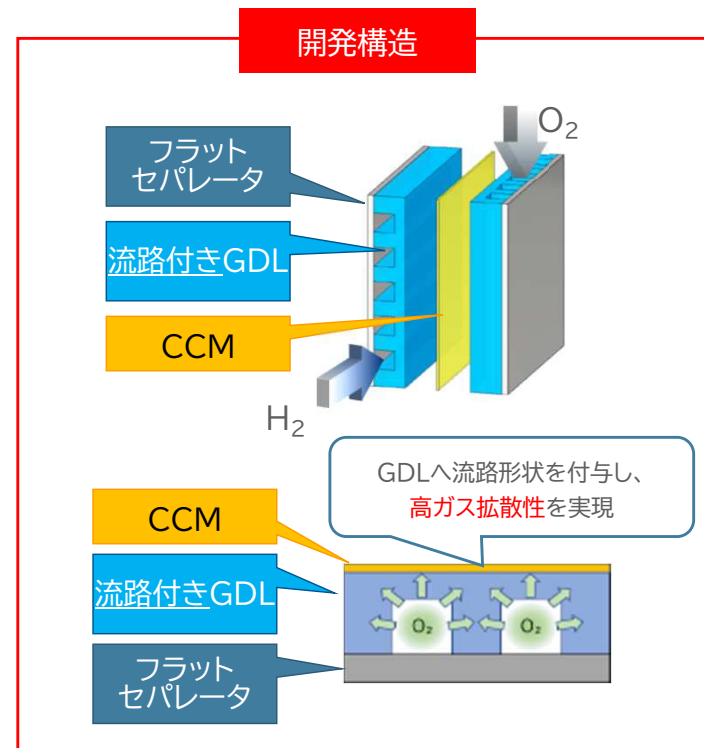
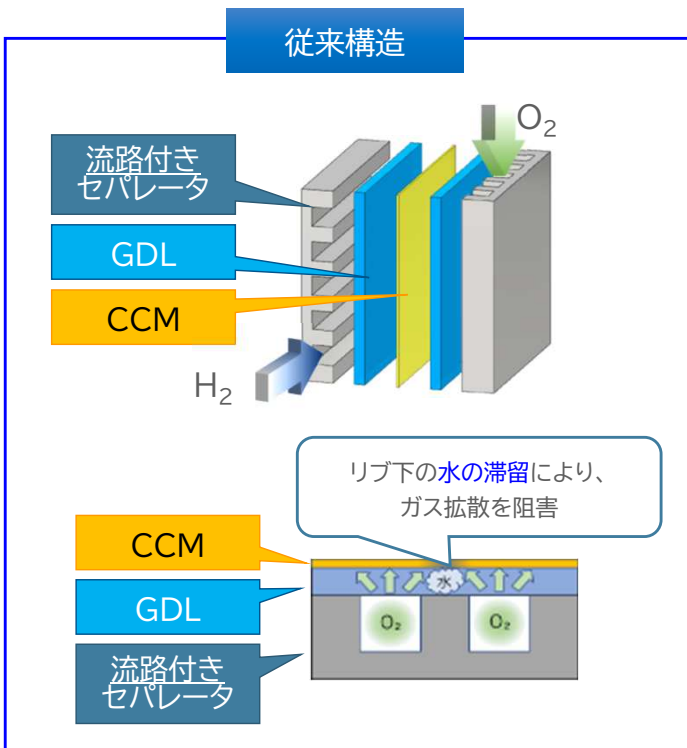
|             |              |
|-------------|--------------|
| 既存工場床面積     | :約 8,776㎡    |
| 増築工場床面積(予定) | :約 7,162㎡    |
| 増築後の工場床面積   | :約 15,938㎡   |
| 総投資額(概算)    | :31億円        |
|             | (建物及び機械、設備等) |

- 2022年3月期の営業利益は20億円となり中期経営計画の数値目標を達成、24年3月期は24億円に上方修正
- パワー半導体向けリードフレームの生産能力を1st STEPに前倒して増強
- コネクタ部品は、ウェアラブル端末向け中心に引き続き旺盛な需要が続き、津軽増築分の利益貢献も加速





- 固体高分子型燃料電池(PEFC)向けガス拡散層(GDL)一体型金属セパレータを山梨大学と共同開発
- 新開発の流路付きGDL(GDLFC+)で大幅な高電流密度化を実現、当社技術により汎用樹脂にガス流路を成形
- 金属セパレータ、GDLを自社生産し、ガスソケットと一体化し、コストを削減
- 2025年に燃料電池車向けのテスト開始、将来は電気自動車、ドローン、緊急電源、エネファーム等での実現を図る



**2021年5月**

日本で初めて制作された国産の燃料電池を電源とする電動アシスト自転車に当社製「ガス拡散層一体型セパレータ」が搭載

**2021年7月**

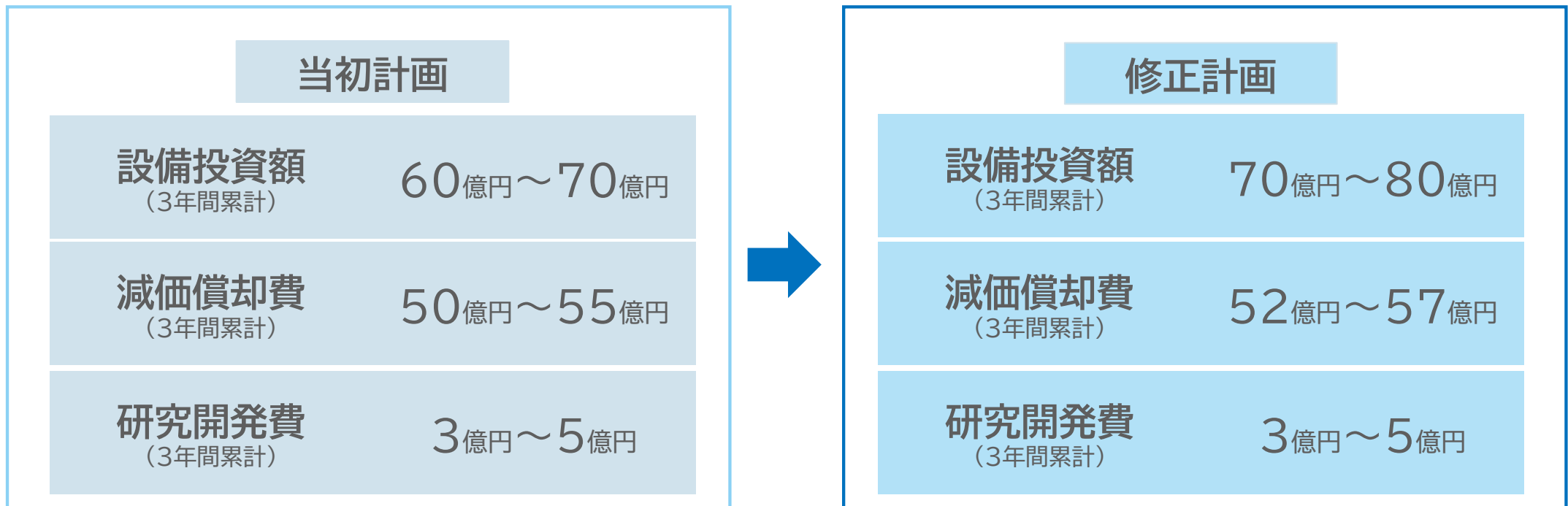
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)共通課題解決型産学官連携研究開発事業に採択

**2022年3月**

山梨大学及び大強度陽子加速器施設・J-PARCと連名で寄稿した論文が『Journal of Power Sources』(Elsevier社)にオープンアクセス版として掲載

流路付きガス拡散層(GDLFC+)が結露抑制や拡散過電圧の上昇を抑制し、燃料電池セルの特性向上に貢献していることを実証

- 中期経営計画期間中の設備投資を60億円～70億円から、リードフレームの増産等により70億円～80億円に増額、これに伴い3年間の減価償却費も従来比2億円増加
- 研究開発は計画通り進捗、当初計画から変更なし



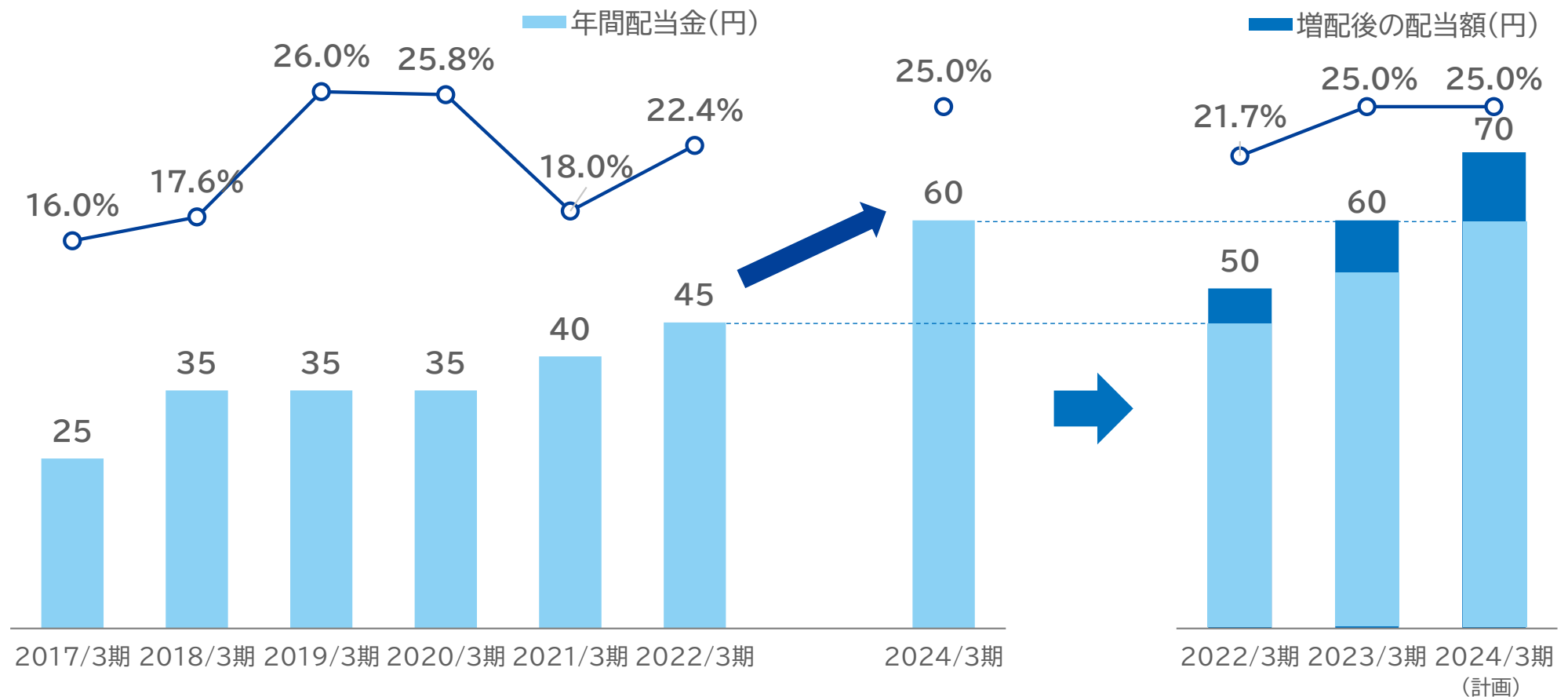
## 主要設備投資

- 津軽工場増築 31億円 (スマートフォン・ウェアラブル端末向けコネクタの増産)
- パワー半導体用リードフレームの増産 10億円
- スマートファクトリー化に向けたデジタル投資 5億円
- 再エネ・省エネ投資 5億円



- ・ ビジョン2030 1st STEPでは、津軽工場への投資等もあり、配当性向25%を目途に安定配当を継続
- ・ 業績上方修正により、2022年3月期の配当を50円に増額、  
2023年3月期は中計最終年度(24年3月期)の**目標値60円を前倒して計画、24年3月期は70円に**

配当金・配当性向の推移



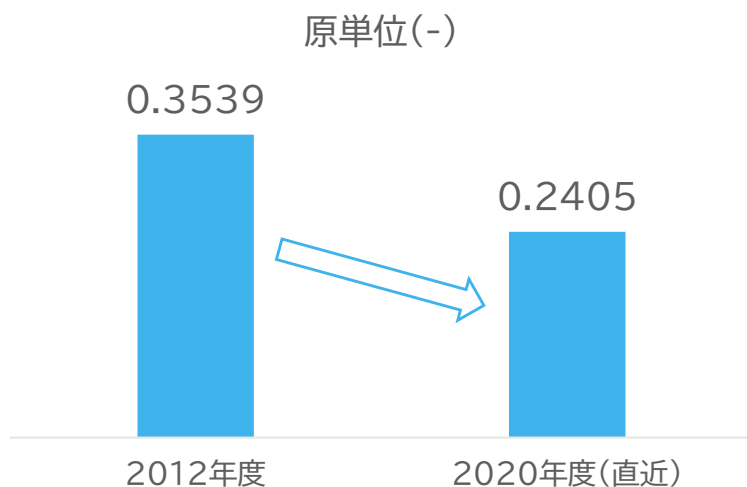
## 7.中期環境計画(SDGsへの取組み)



## これまでの取組み

2012年比 **32%削減** エネルギー原単位\*1

⇒ **業界目標\*2を10年前倒しでほぼ達成済**



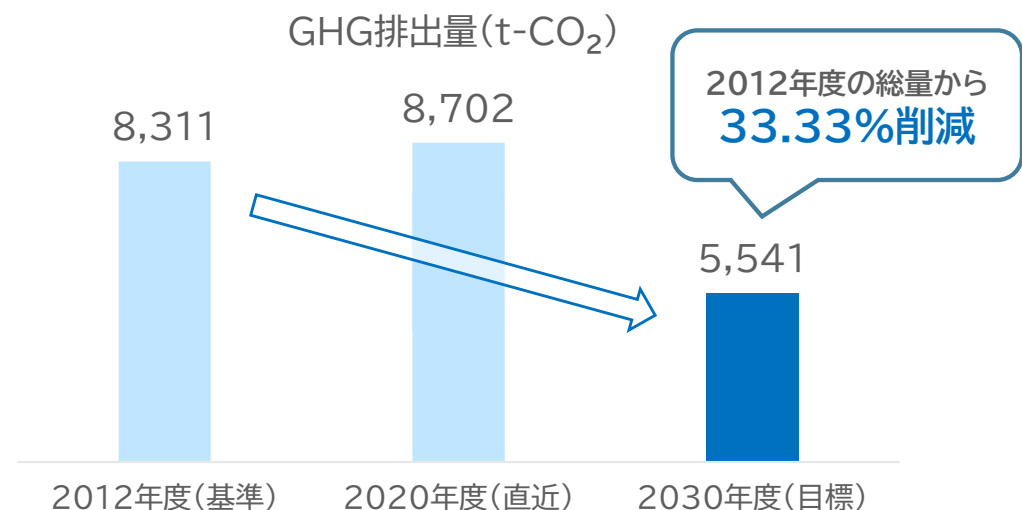
\*1 エネルギー原単位 =  $\frac{\text{エネルギー使用量(原油換算値)}}{\text{売上高}}$

\*2 業界目標 電機・電子業界「低炭素社会実行計画」  
2030年度エネルギー原単位 2012年度比 33.33%以上改善  
参考資料:「電機・電子業界カーボンニュートラルに向けた取組み」  
(2021年4月8日 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー小委員会)

## これからの取組み

カーボンニュートラルに向けて目標のステップアップ  
～原単位から、より厳しく総量へ～

- 生産プロセスにおけるGHG(温室効果ガス)排出量削減  
再エネ活用と省エネ対策



- バリューチェーン全体のGHG排出量削減
- 社会全体のGHG排出抑制に貢献する技術開発  
水素社会の実現(燃料電池部品の開発・実用化)  
EVの普及・省エネへの貢献  
(パワー半導体用リードフレームの拡販)
- 廃棄物・水・プラスチック使用量の削減

2030年度 目標

GHG排出総量 5,541 t-CO<sub>2</sub>

GHG排出削減量 2,770 t-CO<sub>2</sub> {再エネ活用 1,400 t-CO<sub>2</sub>  
省エネ対策 1,370 t-CO<sub>2</sub>

## アクションプラン

1

### 再エネ活用

- 津軽工場への太陽光発電設備の設置 (2023年1月完成予定)など
- カーボンフリー電力の購入

GHG排出削減量 1,400 t-CO<sub>2</sub>  
2012年度比 16.85% 削減

化石燃料による  
電力購入削減量 約3,400,000 kwh

2

### 省エネ対策

コンプレッサー

空調設備

照明機器

その他、生産設備

GHG排出削減量 1,370 t-CO<sub>2</sub>  
2012年度比 16.48% 削減

電力使用削減量 3,161,713 kwh

## 津軽工場へ太陽光発電設備の設置

- ・完成予定:2023年1月
- ・発電容量:約1.7MW
- ・年間発電量:約200万kWh(2023年度より)



(出所) GOOGLE MAP

### 特徴

- ・ 発電量は全て自家消費
- ・ 着雪対策
  - 太陽電池傾斜角度30°
  - 両面受光型太陽電池採用
- ・ 積雪・浸水対策
  - 太陽電池の最低地上高は1.5m
- ・ BCP対策
  - 蓄電池設置

GHG排出削減量:約1,044t-CO<sub>2</sub>

### 参考情報

#### 既存の太陽光発電設備



本社 (上野原)



フィリピン



本社 (塩山)



中国



本社 (塩山・屋根)

国内発電容量  
約0.4MW

海外発電容量  
約1.2MW

既存の発電容量:  
国内海外合わせて  
約1.6MW

津軽発電所完成後の発電容量:約3.3MW

# 8.Appendix



- ・ 増収により売上債権が増加、津軽工場の増設などコネクタ部品等の増産投資により有形固定資産が増加
- ・ 設備投資等により有利子負債も約10億円増加したが、自己資本比率は62.4%と健全

| 単位:百万円        | 2021/3期 | 2022/3期 | 前年期末差 |
|---------------|---------|---------|-------|
| 流動資産          | 14,143  | 17,006  | 2,862 |
| （内、現預金）       | 3,324   | 4,365   | 1,040 |
| （内、受取手形及び売掛金） | 7,224   | 7,790   | 566   |
| 固定資産          | 11,433  | 13,167  | 1,733 |
| （内、有形固定資産）    | 10,222  | 11,861  | 1,638 |
| 総資産           | 25,577  | 30,174  | 4,596 |
| 負債            | 8,838   | 11,545  | 2,707 |
| （内、有利子負債）     | 1,198   | 2,150   | 951   |
| 純資産           | 16,739  | 18,628  | 1,889 |
| 負債純資産         | 25,577  | 30,174  | 4,596 |

- ・ 増益により、営業キャッシュフロー33.3億円と前期比8億円増加
- ・ 津軽工場の増築に伴う支出から、投資キャッシュフローも△29.6億円となったが、フリーキャッシュフローは3.6億円のプラスを維持

| 単位:百万円          | 2021/3期 | 2022/3期 | 前年期末差  |
|-----------------|---------|---------|--------|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,506   | 3,331   | +825   |
| 税引前当期純利益        | 1,457   | 2,083   | +625   |
| 減価償却費           | 1,546   | 1,664   | +118   |
| 棚卸資産の増加         | △360    | △859    | △499   |
| 投資活動によるキャッシュフロー | △2,402  | △2,965  | △562   |
| 有形固定資産の取得による支出  | △2,471  | △2,840  | △370   |
| 財務活動によるキャッシュフロー | △113    | 386     | +500   |
| 短期借入金の純減少額      | △170    | 48      | +218   |
| 長期借入れによる収入      | 500     | 1,000   | +500   |
| 長期借入金の返済による支出   | △124    | △99     | +24    |
| 配当金の支払い額        | △238    | △408    | △170   |
| 現金及び現金同等物の期末残高  | 3,324   | 4,365   | +1,040 |
| フリーキャッシュフロー     | 103     | 366     | +263   |

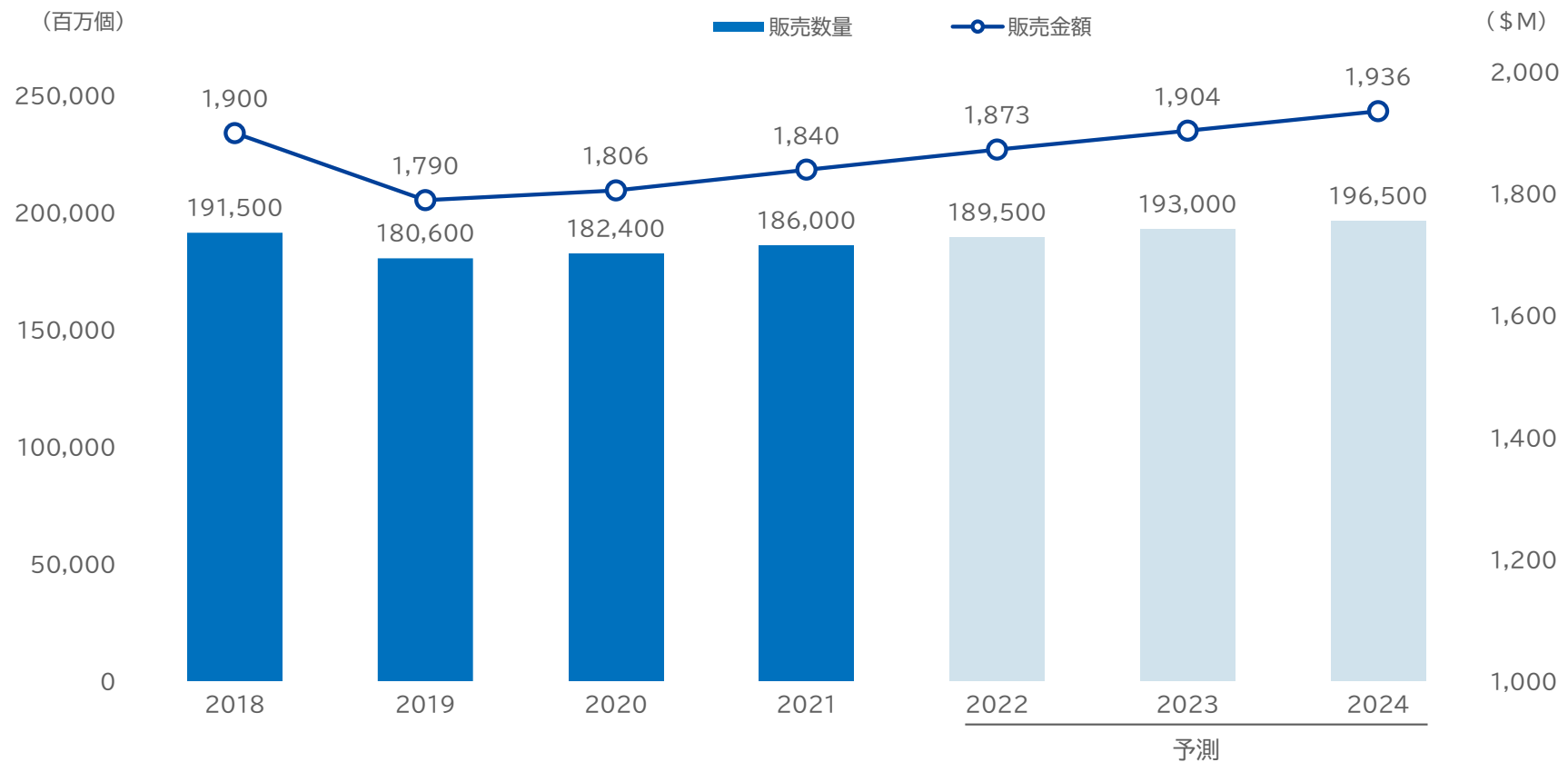


- ・ IC・トランジスタ用リードフレームでは、中国工場などへの積極投資を中計前倒しで計画
- ・ コネクタ用部品は津軽工場の増築工事分が減少するが、生産設備の導入等を今期に計画
- ・ その他は、太陽光発電設備等のGX関連投資による増加を計画
- ・ 津軽工場の増築工事の影響等により、23年3月期の減価償却費は約1.5億円増加

|                   | 2022/3期 | 2023/3期 |        |
|-------------------|---------|---------|--------|
|                   | 実績(百万円) | 予想(百万円) | 前年比(%) |
| 設備投資              | 3,127   | 2,774   | △11.3  |
| IC・トランジスタ用リードフレーム | 330     | 808     | 144.8  |
| オプト用リードフレーム       | 111     | 140     | 26.0   |
| コネクタ用部品           | 2,384   | 1,244   | △47.8  |
| その他               | 301     | 582     | 93.3   |
| 減価償却費             | 1,664   | 1,820   | 9.4    |

- HEV・EVや情報通信機器の電力損失低減のため、パワー半導体への注目が高まっている
- パワー半導体などディスクリートの伸長に伴い、リードフレーム市場の成長は続く  
特に、クリップボンディングリードフレームが増加
- 半導体用リードフレームのグローバルシェアは約5%で世界第9位

## 半導体用リードフレームの世界市場規模推移

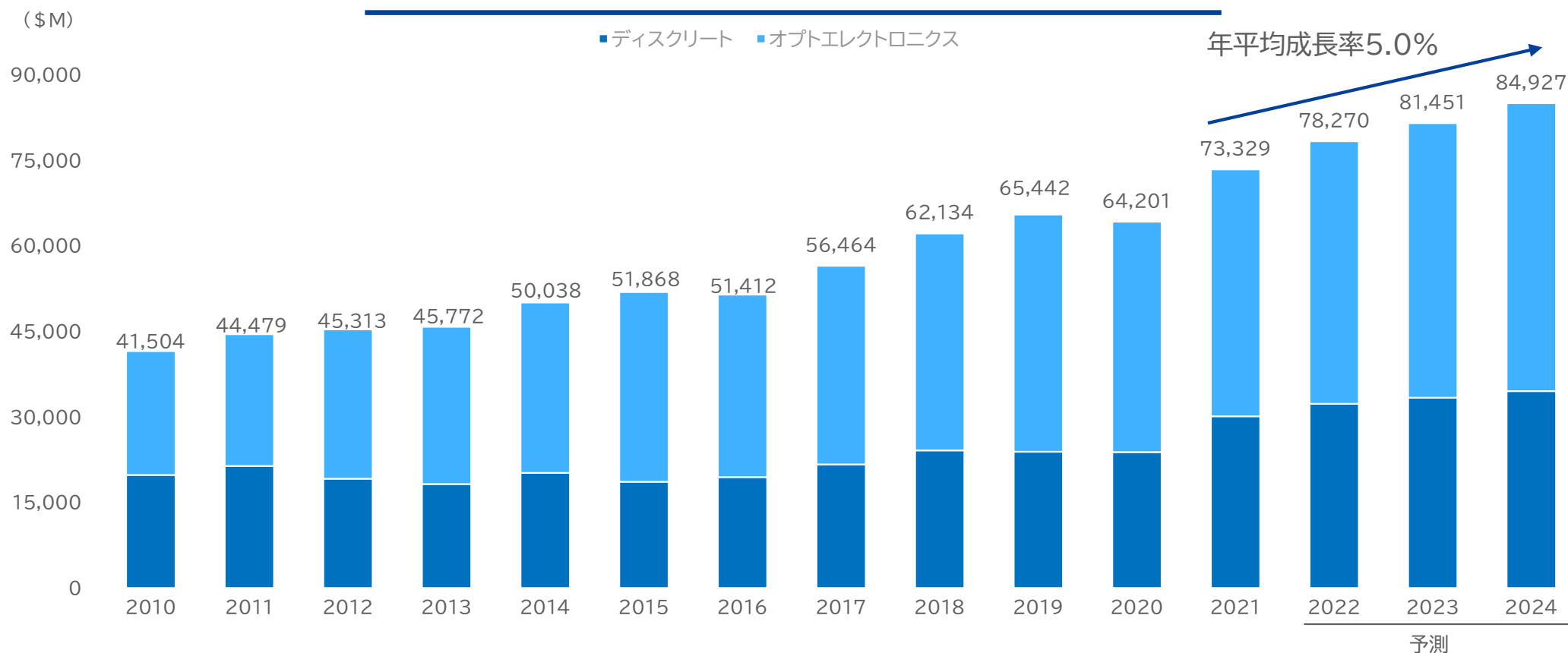


出所: 富士経済「2020年 半導体材料市場の現状と将来展望」

# リードフレーム市場における ディスクリートとオプトエレクトロニクスの動向

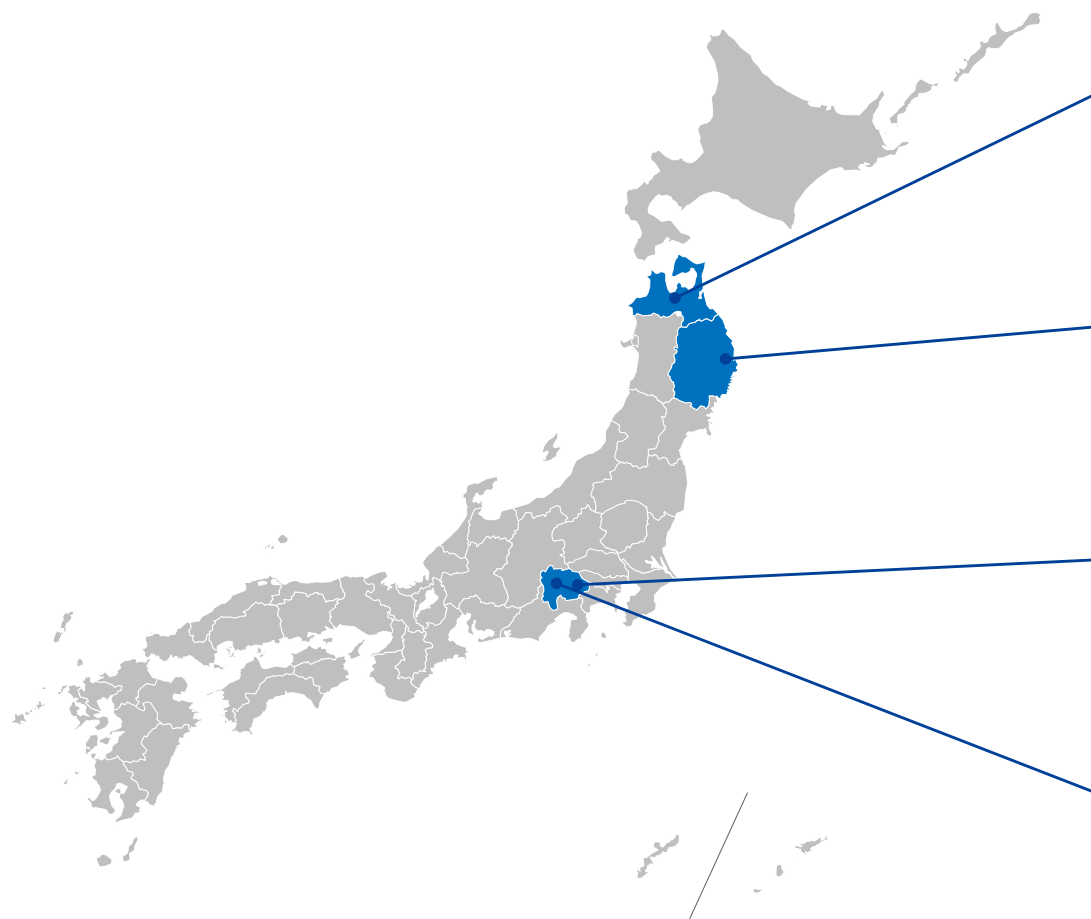
- ・ ディスクリート市場は、パワー半導体等が車載やデータセンター、5G基地局向けなどにより中期的にも大きく成長
- ・ オプトエレクトロニクス市場は、車載向けの搭載率上昇や、デジタルサイネージ・大型ディスプレイの需要回復などの要因から成長が続く

## 世界のディスクリート半導体とオプトエレクトロニクス市場予測



出所:WSTS「世界半導体市場統計」とOmdiaのデータをもとに当社作成

- スマートフォンやウェアラブル端末の需要増加に対応するため、津軽工場を増築し、狭ピッチコネクタの生産能力を増強、5年間の投資額は31億円を計画
- リードフレームはパワー半導体向けなど高電圧・高電流対応品の生産体制を強化



## 津軽工場

主要生産品目

スマートフォン・ウェアラブル端末向けコネクタ



## 岩手工場

主要生産品目

車載向け受動部品

スマートフォン向けコネクタ



## 本社工場(上野原)

主要生産品目

オプト用リードフレーム

リレー部品



## 本社工場(塩山)

主要生産品目

IC・トランジスタ向けリードフレーム

オプト用リードフレーム

- 中山工場(中国)では、リードフレームやコネクタ部品を、金型製作から組み立てまで一貫生産、パワー半導体向けのクリップボンディングリードフレームを量産
- フィリピン工場では、車載向けのコネクタ部品などを、金型製作から樹脂成形まで一貫生産、主に日系の東南アジア拠点向けに販売

## 中国



営業拠点 **ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd**  
生産拠点 **ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.**  
主要生産品目 IC・トランジスタ用リードフレーム  
スマートフォン向けコネクタ部品

## フィリピン



生産拠点 **ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.**  
主要生産品目 エアバッグ向け大型コネクタ部品  
車載向けスイッチ部品  
IC・トランジスタ用リードフレーム

## 注意事項

事業の展望、業績予想等の将来の動向にかかる記載につきましては、歴史的事実ではないため、不確定な要素を含んでおります。

現在入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があることをご了承願います。